

「半導体基盤プラットフォーム」Q&A ※更新箇所：オレンジ部分

	質問	回答
事業内容について		
1	公募要領P6「比較的大規模なクリーンルームや設備群を有し、産学官に共用するための仕組みや専門スタッフ、ノウハウ等を既に一定程度有していること。」、P10「②機関内外の利用者が利用可能な共用設備の運用を主たる目的とした組織体制（機関内の組織規程に明確に位置づけられ専従の職員と共用の設備を有するもの）を機関内に設置していること、あるいは、すみやかに設置見込みがあること。」とは、具体的にはどの程度か。	本事業においては、マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）の一部として実施するものであり、ARIM事業に参画いただきます。そのため、共用装置やそのノウハウがあり、スムーズに事業に参画いただくことを想定しています。経費の使途としても、共用に係る専門スタッフや業務実施費が中心であり、従前からの取組を広げていただくことを想定しています。なお、データに係る取組については、実績の有無を求めるものではありません。
2	「高度なデバイス機能の発現を可能とするマテリアル」領域または「革新的なエネルギー変換を可能とするマテリアル」領域に参画することとなるが、当該2領域が中心に半導体の研究支援等を実施することとなるのか。	ARIMの体制においては、東京大学及び東北大学が当該2領域のそれぞれのハブ機関であり、半導体基盤プラットフォームの中心を担う機関の一つという認識です。
3	本事業に参画するにあたって、既存の共同研究先企業との関係で、企業側にとってのメリットは何か。	本事業参画により、ネットワークの拡大、データ構造化などのノウハウ取得などが想定されます。
経理・契約・様式等について		
1	2.2. 委託費の範囲として、設備備品費の記載がないが、別紙2では設備備品費の記載がある。事業経費として、設備備品費の計上は可能か。	本事業を実施するにあたって、最低限必要となる備品については、計上することは可能です。申請にあたっては、業務実施費の一部として記載ください。
2	雑役務費の修繕に関する費用について、「委託業務に専用されている設備備品で使用中に故障したもの」とあるが、この「専用されている設備備品」とは、学内外共用設備（本事業で取り扱う設備）という理解でよいのか。	ご理解の通りです。
3	また、その場合、既設置の修繕費用として、予防保全的な使途の計上は可能か。	可能です。
4	誓約書の提出は、代表者（弊学の場合学長）の署名（自署）を行ったPDFの提出でよいのか。署名（自署）前のWordの提出も必要か。 また、「法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付」とあるが、上記資料は、WordとPDFの両方の提出が必要か。	当該誓約書は暴力団等反社会的勢力排除の観点ですので、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人、大学共同利用機関法人については誓約書の提出は不要です。なお、前記以外の法人等の場合は、役員の個人情報の提供につき同意いただく内容も含まれることから、自署をお願いすることとしております。
5	提案書に記載されている斜体の文字は、申請時に削除する必要があるか。削除せずそのままでもよいのか。	削除ください。
6	【半導体基盤プラットフォームの事業内容】（4ページ以内）について、記載方法は以下のいずれになるか。 ①説明書きの表と斜体の文字を削除して記載 ②表をそのまま残し、表の下に記載 ③表の右列の斜体の文字を削除し、右枠内に記載	③表の右列の斜体の文字を削除し、右枠内に記載ください。

その他		
1	半導体基盤プラットフォームの予算構造はどうなっているのか。本公募が新規機関の募集の全てか。	半導体基盤プラットフォームとしては、先行して、令和6年度補正予算の66億円にて、ARIM参画機関の設備整備を実施しています。令和7年度当初予算（案）の22億円については、ARIM事業との合計となっており、半導体基盤プラットフォームはその内数となっています。ARIMへの機能追加のための新規機関の募集については、令和7年度は本公募のみとなります。（令和8年度以降は、予算計上前であることから、未定。）